



MANUFACTURES OF CHEMICALS, EQUIPMENT AND ABRASIVES FOR PCB FABRICATION.

MEC Press Release Ref NO. 37-10

HEAD OFFICE: 3-95 SYOWA-DORI AMAGASAKI, HYOGO-KEN, JAPAN TEL 81-6-6414-3451

E-mail info@mec-co.com URL <http://www.mec-co.com>

平成18年1月26日

各 位

上場会社名 メ ッ ク 株 式 会 社
(コード番号: 4971 東証二部 大証ヘラクレス)
本社所在地 兵庫県尼崎市昭和通3丁目95番地
問合せ先 社長室長 坂本 佳宏
TEL 06-6414-3451

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、平成17年10月26日に公表いたしました平成18年3月期(平成17年4月1日～平成18年3月31日)の業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 平成18年3月期 連結通期業績予想数値の修正(平成17年4月1日～平成18年3月31日)
(単位:百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	6,332	1,243	814
今回修正予想(B)	6,665	1,559	1,001
増減額(B-A)	333	316	187
増減率(%)	5.3	25.5	23.0
前期実績	6,012	1,051	676

2. 平成18年3月期 個別通期業績予想数値の修正(平成17年4月1日～平成18年3月31日)
(単位:百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	4,668	724	466
今回修正予想(B)	4,878	882	564
増減額(B-A)	210	157	97
増減率(%)	4.5	21.8	20.9
前期実績	4,457	647	444



3. 業績修正の理由

平成 18 年 3 月期の連結・個別業績ともに、電子基板製造用薬品のフラックス剤、防錆剤、剥離剤等の一部従来薬品の販売が減少したものの、超粗化剤 CZ シリーズが拡大しております。CZ シリーズは半導体パッケージ基板製造の銅表面処理工程において高い占有率を有しており、日本・台湾・韓国において半導体パッケージ基板の生産が拡大していることにより平成 17 年 10 月 26 日に公表した前回発表予想を上回る見通しとなりました。

(注) 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以上